

■巻頭言ー動的平衡から考える組織の永続性／奥野製薬工業 大塚邦顕	
■特集／低炭素社会を支える新機能材料	
特集に寄せて／横浜国立大学 高橋昭雄	160
低炭素社会の実現に貢献する高機能エポキシ樹脂／DIC 小椋一郎	161
高熱伝導性エポキシ樹脂／関西大学 原田美由紀	164
位置選択的分子ハイブリッド法による有機・無機ナノハイブリッドの特性について／荒川化学工業 合田秀樹, 福田 猛	170
LED封止材の最近の開発動向／ダイセル化学工業 奥村浩一	175
■研究論文	
フラックスレス接続可能な低融点Sn系薄膜はんだの開発 ／日立製作所 坂本英次, 秦 昌平, 日立協和エンジニアリング 青木 久, 竹盛英昭, 廣瀬一弘	179
2次元画像検出器を用いた3角測量方式微小ボール高さ検出法／日本大学 原 靖彦, 白井健二, 小林義和, 日立ソフトウェアエンジニアリング 河田成広, ヴィスコ・テクノロジーズ 足立秀之, 滝沢義信, 菅野純一	189
近傍磁界プローブのGHz帯における等価回路化と高空間分解能化／日立製作所 船戸裕樹, 須賀 卓	195
エポキシ変性ポリベンゾオキサジンの研究 ／横浜国立大学, 神奈川科学技術アカデミー 賀川美香, 横浜国立大学 大山俊幸, 高橋昭雄	204
静電容量型センサによる微細プリント配線欠陥検査システムに関する研究 ／東京電機大学 野口祐智, 斎藤之男, 角田興俊, 富田英雄	212
■講座 TSV基礎講座 ①	
シリコン貫通電極(TSV)の重要性和基本構造／長野県工科短期大学 傳田精一	220
■研究室訪問	
八戸工業大学大学院工学研究科電気電子・情報工学専攻藤岡研究室／八戸工業大学 藤岡与周	226
■第25回エレクトロニクス実装学会春季講演大会セッションサマリー	227
本会だより	238
会告	①~④

投稿論文募集中

「エレクトロニクス実装学会誌」では、投稿論文を受け付けております。詳しくはVol. 14 No. 2 (2011年3月号) 151~156ページ掲載の「投稿規程」「査読について」「原稿執筆の手引き」をご覧ください。また、論文投稿に関して問い合わせ等ございましたら、Eメール(hensyu@jiep.or.jp)までご連絡ください。

■ Preface – The Sustainability of the Organization Considered by the Dynamic Equilibrium / Kuniaki OTSUKA	
■ Special Articles / New Function Materials Creating Low Carbon Society	
Intention to the Special Edition / Akio TAKAHASHI	160
High Performance Epoxy Resin to Contribute to Achievement of Low Carbon Society / Ichiro OGURA	161
High Thermal Conductive Epoxy Resins / Miyuki HARADA	164
Properties of Organic-Inorganic Hybrid Material by Site-Selective Molecule Hybrid / Hideki GODA and Takeshi FUKUDA	170
The Latest Developmental Trend of LED Encapsulants / Koichi OKUMURA	175
■ Technical Papers	
Development of the Low Melting Point Sn-Based Thin Film Solder Possible to Join with Fluxless / Eiji SAKAMOTO, Shohei HATA, Hisashi AOKI, Hideaki TAKEMORI, and Kazuhiro HIROSE	179
Detection of Height of Minute Balls Based on Triangulation Using Detected 2-D Images / Yasuhiko HARA, Narihiro KAWADA, Kenji SHIRAI, Yoshikazu KOBAYASHI, Hideyuki ADACHI, Shigenobu TAKIZAWA, and Junichi SUGANO	189
Equivalent Circuit at GHz band and Improvement of Spatial Resolution for Magnetic Near-Field Probe / Hiroki FUNATO and Takashi SUGA	195
Study on Polybenzoxazine Modified with Epoxy Resin / Mika KAGAWA, Toshiyuki OYAMA, and Akio TAKAHASHI	204
A Study on Defect Inspection System for Minute Printed Wiring Boards by Using Capacitance Type Sensor / Masanori NOGUCHI, Yukio SAITO, Okitoshi TSUNODA, and Hideo TOMITA	212
■ Tutorial Series – The Basic Concept, Standard Structures and Fabrication Technologies of Through Silicon Vias ①	
Significance and Fundamental Structure of Through Silicon Via / Sei-ichi DENDA	220
■ Report – Fujioka Laboratory, Doctor of Science Program in Electronic, Electrical and Information Engineering, Graduate School of Engineering, Hachinohe Institute of Technology / Yoshichika FUJIOKA	226
■ Report – The 25th JIEP Annual Meeting	227
News	238
Announcement	①~④

■ 会 長 友景 肇	■ 副会長 越地 耕二	若林 信一							
■ 編集委員会 委員長・安東 泰博	副委員長・高橋 康夫	末松 憲治	平 洋一						
委員 (五十音順)・赤星 晴夫	安食 弘二	伊藤 寿浩	碓氷 光男	榎 学	海老原理徳				
折井 靖光	越地 耕二	小林 一治	澤田 廉士	白石 洋一	高原 秀行				
塚田 裕	塚本 健人	箕輪 俊夫	山中 公博						
